



NEDIA 通信

- NEDIA 第 1 回通常社員総会を開催
- 新入会員
- NEDIA Give & Take コーナー
- 事務局からのお知らせ

(一社)日本電子デバイス産業協会 事務局
〒101-0025 東京都千代田区神田佐久間町 2-13
竹内ビル 202
TEL : 03-5823-4465 FAX : 03-5823-4475
E-mail : info@nedia.or.jp

■NEDIA 第 1 回通常社員総会を開催

2014 年 5 月 26 日(月)16:00 から日本教育会館 9 階喜山倶楽部飛鳥において、NEDIA 第 1 回通常社員総会を開催しました。正会員数 140 社に対し、委任状を含め 84 社の出席を得て、第 1 回通常社員総会は有効に成立しました。

齋藤昇三代表理事・会長が議長を務め、開会の挨拶及び議事進行ルールの説明と協力要請を



議長の齋藤代表理事・会長

行いました。

議長の指示により周藤常務理事・事務局長が第 1 号議案「2013 年度事業報告」及び第 2 号議案

「2013 年度事業報告・監査報告」に関し、2013 年度事業報告及び決算報告を行い、その後に詫摩監事が監査報告を行いました。



社員総会会場の様子

つづいて周藤常務理事・事務局長が、第3号議案「2014年度事業計画」及び第4号議案「2014年度収支予算」について説明しました。

第1号議案から第4号議案まで説明を行った後に、齋藤議長が各議案に関し、正会員に質問及び動議を含めた審議に関する発言を求めたところ、特に提案はなく、議案の採決に入りました。まず第1号議案及び第2号議案について、出席正会員の過半数の賛成を得て、原案どおり承認可決されました。つづいて第3号議案及び第4号議案についても、出席正会員の過半数の賛成を得て、原案どおり承認可決されました。

以上をもって、本総会の議事を終了、齋藤議長は、今後のNEDIAの発展について、出席会員及び役員に協力を要請して、閉会を宣しました。

通常総会の第4号議案において全理事・監事・顧問の留任が承認されており、つづいて臨時理事会を開催し、役職についても全員留任の決議を行いました。今後も齋藤代表理事・会長のリーダーシップのもとにNEDIAの発展を推進することになります。

17:00 から総会会場の隣の光琳で懇親会を開催しました。司会は泉谷理事・副会長が務め、招待者を含め90名の多数の参加で賑やかに始まりました。



主催者挨拶の齋藤代表理事・会長

最初に齋藤代表理事・会長が主催者挨拶を行い、第1回通常総会において提案議案は問題なく承認され滞りなく終了した旨の報告がありました。その上で、2014年度事業計画に沿ってNEDIAの発展に向けて推進して行くとの決意を表明されました。



司会の泉谷理事・副会長

来賓挨拶は、最初に経済産業省商務情報政策局情報通信機器課の浅川浩二課長補佐から成長戦略推進についてのお話があり、つづいてSEMIジャパンの中川洋一代表からセミコンへのNEDIAブース設置のお話があった。引き続き大見理事・副会長の乾杯の発生により、賑やかな懇談が始まりました。

懇談の合間に来賓の日本半導体商社協会の大西利樹会長、一般社団法人半導体産業人協会の

橋本浩一理事長に挨拶をいただきました。さらに10月に予定している電子デバイスフォーラム京都で共催でサポートいただくリードエグジビジョンジャパン株式会社第一事業本部の古賀次長に挨拶をいただきました。



来賓挨拶の経産省 浅川課長補佐



来賓挨拶のSEMI ジャパン 中川代表



乾杯発声の大見理事・副会長



来賓挨拶のDAFS 大西会長



来賓挨拶の SSIS 橋本理事長



挨拶のリードジャパン 古賀次長



中締めの佐藤和樹理事・副会長



賑やかな懇親会場

最後に佐藤和樹理事・副会長のユーモアを交えた中締めにより、懇談会は盛況のうちに開きとなりました。 佐

■新入会員

2014年5月に下記の方の新入会が理事会承認されました。

<正会員>

◇アートワーク(株)

ノイズを消す設計
EMSで試作～量産まで製造
ハード・ソフト開発、プリント基板のアートワーク設計、製造

◇旭化成イーマテリアルズ(株)

バッテリーセパレータ、フォ

トマスク防塵保護膜、プラスチック光ファイバ
フレキシソ印刷用感光性樹脂、エポキシ樹脂、感光ポリイミド、PBO
感光性ドライフィルム、プリント基板用ガラスクロス

◇(株)イオンテクノセンター

イオン注入及び表面加工・分析
また外部と連携した共同研究共同開発

◇(株)アドテックエンジニアリング

露光装置等の設計、製造、販

売、保守

◇ラピスセミコンダクタ(株)

ロジック LSI、メモリ LSI、表示用ドライバ LSI の開発、製造、販売
ファンダリビジネス

<賛助会員>

◇(一財)浅間リサーチエクステンションセンター

(相互入会の賛助会員)
産学間連携に関する事業

<個人>

引頭麻実

■NEDIA Give & Take コーナー

注：このコーナーは会員から売り込みたいと思う製品・サービス・技術等に関する情報、または探している製品・サービス・技術等に関する情報を集め、載せるコーナーです。情報の受け付けは随時行っておりますので、ご活用お願い致します。

ベンチャーはこの技術とビジネスモデルで成功している。

会社概要

ファルコン電子株式会社は、台湾 HI-LO SYSTEMS 社との共同出資で設立された日本法人です。HI-LO SYSTEMS 社には 300 名の従業員がおり、そのうちの約 150 名は技術者で、約 20 名は技術分野の修士号を取得しています。弊社では、FALCON のブランドのデバイスプログラマ、自動書込装置、3 次元外観検査装置、ROM 書込サービスをグローバルに展開しています。

HI-LO SYSTEMS 社はデバイスプログラマ関連事業専門として、グループで約 30 億円の売上があり、世界最大級のデバイスプログラマ事業者ではありますが、小さなビジネスの積み重ねを大切にしております。弊社の売上は、今事業年度約 2 億円を計画しています。

HI-LO SYSTEMS 社と弊社で、ROM 書込サービスは、約 2,500 ミリオン (25 億) 個の IC の書込実績があり、ワールドワイドで、月産 30 から 40 ミリオンの書込サービスを行っております。

ROM 書込サービス以外の事業として、検査専門事業をスタートした 2007 年からの累計で、IC の外観検査の実績はグループ全体で 672 ミリオンになります。

成功の要因

1. デバイスプログラマ専門を中心に、全てグループ内で設計、製造した自動装置を中心に、外観検査サービス、ROM データ書込サービス、テストハウス事業など、ラインエクステンションで事業を拡大しています。
2. HI-LO SYSTEMS 社は台湾を中心に、香港(HI-LO SYSTEM)、日本 (ファルコン電子)、米国 (HI-LO REP) にマーケティングや書込サービスのグループを形成し、お客様のご要望を応えることで、ワールドワイドに大手セットメーカからの受注を拡大させています。
3. 独立系資本提携グループ内で、開発、製造、マーケテ

ファルコン電子株式会社

イング行い、独立独歩の経営を実現しています。

4. ISO/TS16949 の認証を取得して、車載向のお客様への書込サービスをグローバルに展開し、アウトアウトの作業により、コスト削減と納期の短縮を実現している。横浜工場パイロットランを行った上、日本からの指示で、日本的品質を維持した ROM データ書込や、外観検査、テーピング等の海外生産を実現しています。
5. アミューズメント、車載、大手セットメーカ、半導体メーカと NDA を結び、最先端技術を駆使した、グローバルな情報管理システムを構築しています。
6. エンジン (デバイスプログラマ、画像処理ソフト) と搬送系の両方の技術を兼ね備え、「デバイスプログラマ + ハンドラ」を併設するという考えの設計では無く、データ自動書込装置としてシステムティックな設計製造、また単に「画像テスト

「+ハンドラ」では無く、両者を有機的に結合させた自動外観検査装置を設計製造し、マニュアル作業による、カンやコツに頼る IC の位置決め作業を極力排除している。

成功を生んだ技術

デバイスプログラマ、自動書込装置に関する技術は、JASVA 2012 年 12 月号に掲載していただきましたので、ここでは、自動画像検査装置を紹介させていただきます。

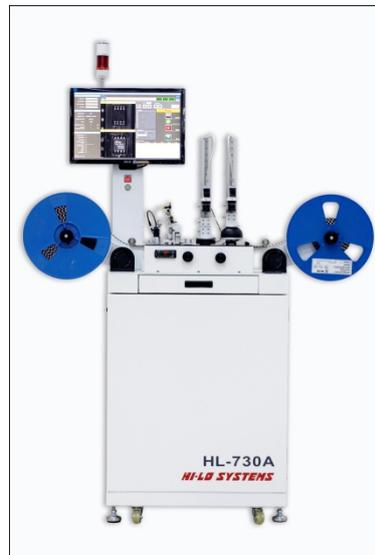
自動画像検査装置

ソフトライブラリを使い、お客様のご要望に応じた検査対象や、閾値（しきい値=スレッシュホールド）を任意に変更出来るソフトアルゴリズムを設計、キャリア媒体の形状や、IC の大きさ、外観検査計測方法により、様々な自動検査装置を用意しています。多くのハンドラに採用されている、簡易的な位置決め目的の為、IC エッジ検出ではなく、IC の画像認識（PVI）を行っています。

テープ格納 IC 用検査装置 (HL-730A)

テープ品の書込サービス、半導体メーカーのテストハウス事業に使われています。最大 UPH は 30K です。ファルコン電子横浜、

台北、香港書込工場に設置されています。



主な検査機能

- ・ポケット内の IC の向き
- ・ポケット内の IC のドット（ドットの有無、ドットのサイズ、ドットの欠ける）
- ・ポケット内の IC の有無
- ・ポケット内の IC の重なり
- ・カバーテープのシーリング（位置、シーリング不良）
- ・ポケット内の IC のリード曲がり
- ・ポケット内の IC のレーザーマーキング
- ・ポケット内の IC の PVI（Package Vision Inspection）

トレー格納 IC 用検査装置 (S-120, HL-770)

テープ品の書込サービス、半導体メーカーのテストハウス事業に使われています。最大 UPH は 12K (S-120), 35K (HL-770) です。

S-120, HL-770 の特徴は、2 次元、3 次元、ソート（PASS, NG）を 1 台のシステムで行えることです。台北、香港書込工場に設置されています。ファルコン電子に近日導入予定です。



主な検査機能

1. リード付き IC
 - ・リードコプラナリティ
 - ・リードスタンドオフ
 - ・リードピッチ
 - ・リードスキュー
 - ・リードスパン
 - ・リード幅
 - ・リード長さの違い（リードデビエーション）
 - ・ターミナル長さの違い（ターミナルデビエーション）
 - ・リードスラント
 - ・リードスイープ
2. ボール付き IC
 - ・ボールコプラナリティ

- ・ボールピッチ
- ・ボールオフセット
- ・ボール高さ
- ・ボール幅
- ・グリットとパッケージのオフセット
- ・反り
- ・ボディー幅
- ・ボディー高さ

六面外観検査装置 (HL-750)

チップレジスターや MLCC などをボール供給で、6 面方向で外観検査する装置、台湾の新竹工場に導入されています。UPM (毎分検査量)は 1.8K。

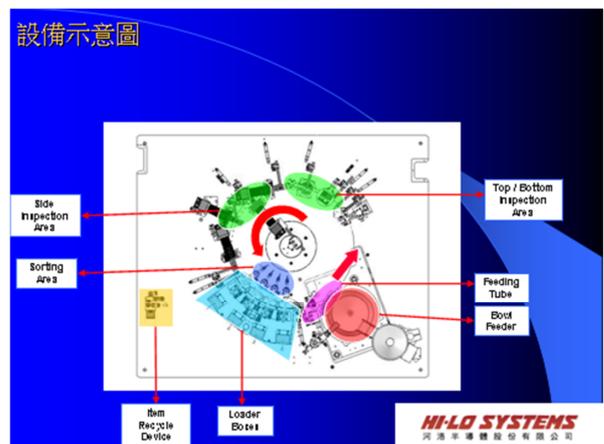
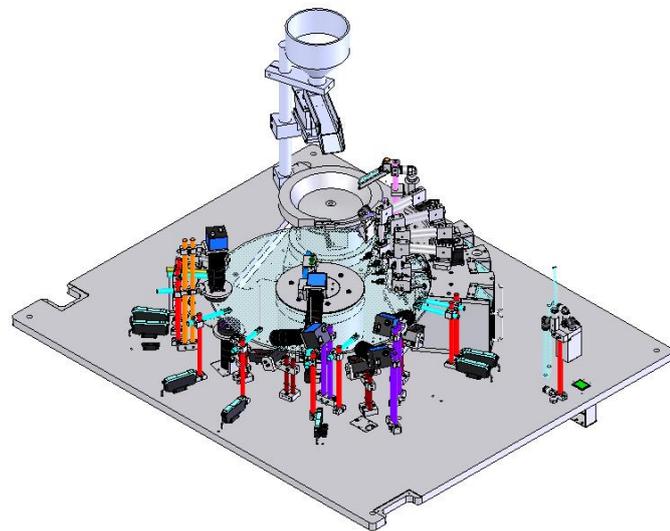
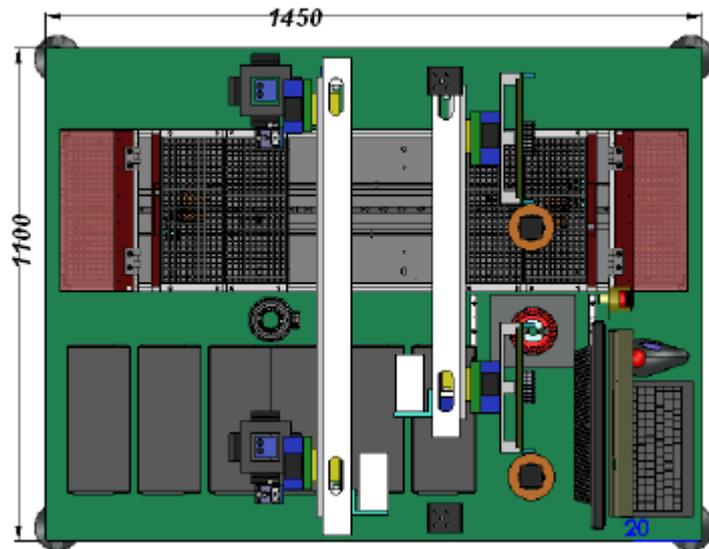
主な検査機能

- ・パッドのショート
- ・パッドの汚れ
- ・基板の露出
- ・パッドサイズエラー
- ・傷
- ・パーティクル
- ・マークの NG
- ・半田のはみ出し

これらの自動外観検査装置の他にも、ワイヤーボンディングの自動検査装置も現在開発中です。デバイスプログラマ、IC テストハウス事業、外観検査事業など、お客様のご要望にあわせた装置の開発、販売、サービスの提供が可能です。半導体業界にこだわらず、異業種で、私ども

が得意とする画像処理技術を駆使した設備やサービスを、ラインエクステンション展開として推進も予定しています。

今後共、変わらぬご支援をお願い申し上げます。



■事務局からのお知らせ

●会員名簿2014年版データ提出を大至急提出お願い致します。

会員名簿 2014 年版のデータの提出をお願いしておりますが、期限(6月11日)が過ぎておりますので、未提出の会員は大至急提出して頂きたく、よろしくお願ひ致します。

●「NEDIA DAY 東北&第2回技術情報交換会および交流会」開催のご案内

日本電子デバイス産業協会(東北NEDIAおよびJSENA部会)は 2014年7月10日「NEDIA DAY 東北&第2回技術情報交換会」を開催いたします。

・NEDIA DAY 東北は、旧JASVA DAY 東北の位置付けとなります。

ここでは、医療、MEMSに焦点を当て、より現場に近い内容のプレゼンを行います。

・第2回技術情報交換会はJSENA部会を知って頂くことが目的で、JSENA部会の

活動内容やJSENA部会に参加している会社が何を行っているかをプレゼンします。

・交流会は、参加者がざっくりと名刺交換やプレゼン内容やお互いの

意見交換をしていただく場で

す。皆様のご参加をお待ちしております。

東北NEDIA代表 川添良幸
JSENA部会長 和田悟

日時：2014年7月10日(木)

場所：NEDIA DAY 東北&第2回技術情報交換会：
東北大学金属材料研究所講堂(片平キャンパス)
交流会：レストラン萩(東北大学片平キャンパス内)

<http://www.tohoku.ac.jp/japan/ese/profile/campus/01/katahira/>

主催：(一社)日本電子デバイス産業協会(NEDIA) JSENA部会、東北NEDIA

参加費：NEDIA DAY 東北&第2回技術情報交換会は、NEDIA会員)無料、一般)2000円
交流会は、会員&一般)4000円
<プログラム>：

【NEDIA DAY 東北】

13:30「挨拶と東北NEDIA活動」
川添良幸氏/東北

NEDIA代表

13:40「半導体技術による高性能部品MEMS」

江刺正喜氏/東北大学

原子分子材料科学高等研究機構(WPI-AIMR)教授(兼)マイクロシステム融合研究開発センター長(μSIC)

14:25「医療の世界と先端エレクトロニクス～医療ビ

ジネスの今 分析/解析装置～」
中川原寛一氏/(株)日本遺伝子研究所 代表取締役研究所長

15:10 休憩

【第2回JSENA部会技術情報交換会】

15:25「挨拶とJSENA活動報告」
和田悟氏/JSENA部

会長・関西NEDIA副代表

15:35「ウエット系製造装置用純正交換部品のご紹介」
土肥司氏/ファーストゲート(株)

15:55「凌和電子の紹介と事業展開」

板垣篤氏/凌和電子(株)

16:15「設備機器の基板修理・復刻」

八重樫幸夫氏/(株)パターンアート研究所代表取締役

16:35「半導体製造設備のメンテナンス事業展開」

柴田弘明氏/(株)OMT

事業推進グループ長

16:55「閉会の挨拶と交流会のご案内」

千葉芳弘氏/東北NEDIA

副代表・JSENA部会

【交流会】

17:00 交流会

19:00 閉会

■申込書

・NEDIA DAY 東北&第2回JSENA部会技術情報交換会および交流会

会社名：

所属・役職：

氏名：

連絡先(e-Mail) :

交流会:(出席・欠席)

※どちらかを消してください

会員区別:(NEDIA 会

員・非会員) ※どちら

かを消してください

■申込先/問合せ先

・NEDIA 事務局:

info@nedia.or.jp

*申込期限は6月30日迄で
す。

*定員に達し次第、締め切ら
せていただきます。

●第35回 アナログ技術 トレンド (HAB 研) セミナ のご案内

※高周波・アナログ半導体技術
セミナーより、セミナー名称を変更
しました

ハイブリッドカーや電気自動車、電車、産業機器、太陽光発電などにおいて、パワーモジュールを用いた高効率の電力エネルギー変換は非常に重要なキー技術です。特に、パワーモジュール及び放熱機器には、小型・高密度化、大放熱、高耐熱が要求されています。パワーモジュール及び放熱機器の発展は、益々、電力エネルギー変換性能の向上、省エネに貢献し、パワーエレクトロニクス市場を拡大するものと期待されています。

そこで、今回は、「パワーモジュール放熱技術の動向」をテーマに、この事業・技術分野の最

先端でご活躍の方々を講師としてお招きし、下記の要領でセミナーを開催致します。

パワーモジュールとその放熱技術の最前線情報をお聞きいただき、皆様の活動に資することができればと思います。多数の皆様のご参加を心よりお待ちしております。

記

■テーマ: 「パワーモジュール
放熱技術の動向」

■日時: 平成26年7月15日
(火) 14:00~17:00

(セミナー終了後、交流会が行われます。)

■場所: 京都テルサ 西館3階

第2会議室 (京畿研

民総合交流プラザ内)

■内容:

基調講演: 「未定」

加柴 良裕 氏

(三菱電機株式会社 生産技術
センター)

講演: 「各種接触熱抵抗低減材

料の有効熱伝導率測定法とヒ

ートパイプ式高性能空冷ヒー

トシンクの開発事例紹介」

大串 哲朗氏 (広島国際大学

工学部情報通信学科客員教授)

講演: 「未定」

西村 隆 氏 (三菱電機株

式会社 先端技術総合研究所)

■参加費: 講演会 HAB 研会

員・NEDIA 会員は無料、

非会員は5,000円

(交流会 会員・非会員とも

2,000円)

■主催: NPO 法人 高周波・アナログ半導体ビジネス (HAB) 研究会

■協賛: 一般社団法人 日本電子デバイス産業協会 (NEDIA) (予定)、(株)産業タイムズ社 (予定)

■参加お申込み: 下記 URL よりお申込下さい。

URL:<http://www.npo-hab.org/050.html> (最新情報を随時、掲載しております。)

定員 60名 ※定員に達し次
第、締め切らせていただきます。

申込み締切日: 平成26年7月8
日(水)

※締切日前であっても、定員に達しましたら、締め切らせていただく場合がございます。お早めにお申し込み下さいませ。

●「第4回 JAST 部会主催 勉強会」開催のご案内

日時: 2014年8月25日
(月)13:00-16:00

場所: 御茶ノ水めっきセンター

「電解水とナノバブルについて」

佐藤運海氏/信州大学教育

学部 工学博士・教授

「2014年度後半以降の半導体

産業の動向を考える」

三好文明氏/ネットグラフ

サービス・オーナー

(詳細は別途連絡致しますので、ご予約をお願い致します)

●「SSIS-NEDIA シンポジウム in 大阪」開催のご案内

日時：2014年8月28日(木)13:30-17:00

場所：大阪大学中之島センター7階講義室 703

「2030年に向けて～次の15年サイクルで求められるもの～」

山本義継氏/BNP パリバ証券(株)調査部シニアアナリスト

「More than Mooreにおける新たな挑戦」

高須秀視氏/ローム(株)常務取締役

「IV族半導体を用いたスピントロニクス」

白石誠司氏/京都大学大学院工学研究科電子工学専攻 教授

17:00-18:30 交流会 9階交流サロン

8月29日(金)にオープンゴルフも設定しています。

(詳細は別途連絡致しますので、ご予約をお願い致します)

●「NEDIA 電子デバイスフォーラム京都」開催のご案内

開催日：2014年10月30日(木)～31日(金)

場所：京都リサーチパーク (KRP)

A、B、C、Dの4会場で、NEDIAならではの川上から川下に至る幅広い分野にわたる

電子デバイス関連産業の将来を発信します。

現在プログラム策定中ですが、近々詳細を告示してまいりますので、ご予約をお願い致します。

●「NEDIA Day 九州」開催予告

開催日：2014年10月30日(木) or 31日(金)

場所：北九州学術研究都市

時間帯及びプログラムの詳細は未定で、詳細は別途連絡致します。

会員イベントのご紹介

● 第129回 ひびきのサロン・ひびきの半導体アカデミー合同企画「最先端の光ソリューションで研究開発とビジネスの可能性を探る」のご案内

レーザー光は、工業、科学研究、医療、軍事、芸術など応用範囲は極めて広く様々な分野で活用されています。本サロンでは、レーザーについて、製品開発企業と研究者よりバイオ研究と環境計測分野での応用技術や、新たな活用技術の最前線をご紹介します。

また、今回は講演会終了後に20～30分程度、講演者との名刺交換会を予定しております。・産学連携に興味がある、挑戦したい。・大学や企業と共同研究開発を行いたい。・自社の技術的な課

題解決の為に、大学や企業を利用したい等ございましたら是非ご参加下さい。

■テーマ：最先端の光ソリューションで研究開発とビジネスの可能性を探る

～ バイオ研究・環境計測分野等へのレーザー用光学機器・光学システムの応用 ～

■日 時：平成26年6月26日(木)14:45～17:30：講演会

17:30～(20～30分程度)・名刺交換会

■場 所：北九州学術研究都市 産学連携センター2階 中会議室1

(北九州市若松区ひびきの1番3号)

■主 催：公益財団法人北九州産業学術推進機構 [FAIS]

■内 容：

14:50～15:40【講演1】最先端のレーザー応用技術の支える光学機器の最前線！

シグマ光機株式会社 九州営業所 所長 仲家 洋 氏

15:40～16:30【講演2】微粒子(PM2.5等)計測など、レーザーが実現する光ソリューションの最前線

早稲田大学大学院情報生産システム研究科 助教

池沢 聡 氏

16:40～17:30【講演3】赤外線レーザーを使った遺伝子発現システムの最前線 自然科学研究機構 基

礎生物学研究所 生物機
能解析センター光学解析
室 特任准教授

亀井 保博 氏

17:30～(20～30 分程度)

名刺交換会

■内容詳細はこちら

⇒

<http://www.ksrp.or.jp/fais>

[/iac/news/archives/2014/
001634_0514_102514.ht
ml](/iac/news/archives/2014/001634_0514_102514.html)

■お申し込みはこちら

⇒

[https://www.ksrp.or.jp/fai
s/iac/project/salon/index.
php?form=84](https://www.ksrp.or.jp/fais/iac/project/salon/index.php?form=84)

【お問い合わせ】

公益財団法人 北九州産
業学術推進機構

産学連携部 連携企画担

当課 内田・永富・一田

tel 093-695-3006

(内線 1065)

fax 093-695-3018